

证券代码：688368

证券简称：晶丰明源

公告编号：2026-052

上海晶丰明源半导体股份有限公司

关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月16日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。该事项尚需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、变更注册资本的相关情况

（一）募集配套资金向特定对象发行股票

公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金向特定对象发行股票最终获配发行对象共计18名，发行股票数量为16,861,826股。本次发行新增股份已于2026年4月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续并取得《证券变更登记证明》。具体情况详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金向特定对象发行股票的发行结果暨股本变动公告》（公告编号：2026-033）。

本次发行完成后，公司新增16,861,826股有限售条件流通股，公司总股本由128,852,867股增加至145,714,693股，注册资本由12,885.2867万元增加至14,571.4693万元。

（二）实施2025年年度权益分派

公司2025年年度利润分配及资本公积转增股本已于2026年6月9日实施完成，具体方案为以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利10元（含税）、以资本公积向全体股东每10股转增4股。具体情况详见公司于2026年6月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海晶丰明源半导体股份有

限公司 2025 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-042）。

本次权益分派实施完成后，公司总股本由 145,714,693 股增加至 203,635,138 股，注册资本由 14,571.4693 万元增加至 20,363.5138 万元。

二、修订《公司章程》的具体情况

基于前述事项，公司股本总数和注册资本发生变动，拟对《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修订。具体内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 12,885.2867 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 20,363.5138 万元。
第二十一条 公司已发行的股份总数为 12,885.2867 万股，均为人民币普通股。	第二十一条 公司已发行的股份总数为 20,363.5138 万股，均为人民币普通股。

除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。本次变更注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交股东会审议，同时提请股东会授权公司管理层或其授权代表向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记等相关手续。

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》已同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

上海晶丰明源半导体股份有限公司

董 事 会

2026 年 6 月 18 日